

《长川调研》一、与 H 客户的合作历史及产品技术情况合作起源与演进:长川与 H 的合作始于四五年前。因贸易环境变化 H 无法采购爱德万(Advantest)测试机, 转而寻求国内供应商。当时长川缺乏高端 SoC 测试机能力, H 派专家与长川共同开发, 成功研发出第一代 8 槽位 SoC 测试机。该平台通过配置不同板卡(部分自研数字板卡, 部分采购第三方模拟板卡)满足需求, 为长川奠定了基础。平台通用性与型号区分:长川的测试平台是通用的, 通过配置不同板卡适应各类芯片(如 SoC、GPU 等)测试, 模式类似国外 93K 平台。型号以数字区分规格, 如“9,000”系列支持 8 张资源板卡, 9,016”系列支持 16 张板卡;前缀字母用于区分具体应用。

技术差距与追赶预期:与行业标杆 93K 相比, 长川的主要技术差距在于测试主频(涉及 FPGA 及软硬件设计)。长川已投入约 200 人、耗时两年建立起基础平台, 预计还需 1-2 年可追平 93K 水平。

二、2026 年业务增量、分布及出货预期总体出货预期:相较于 2025 年, 2026 年长川测试机总出货量预计同比增长 15%至 20%。9,000 与 9,016 系列情况:

出货比例:预计维持 9,016 占 70%、9,000 占 30%的结构。因 9,016 是根据 H 需求开发的升级版, 性能更优, 客户无需再采购有瓶颈的 9,000。

均价:9,016 系列均价约 500 万元, 9,000 系列均价 200-300 万元。客户分布:2021-2025 年间绝大部分交付给 H 客户。2026 年 H 客户采购量预计为几百台规模, 非 H 客户出货量预计近 100 台。细分产品线出货情况:

数字 SoC 测试机:出货表现稳健, 是主力产品, 2026 年增量平稳, 预计同比增长 15%-20%。

GPU 测试机:2025 年出货极少, 因基数小, 是 2026 年最大的增量来源, 预计 2026 年出货 100-200 台。

存储器测试机:2025 年出货仅几十台, 尚未大规模放量, 仍需成熟优化。

供应链情况:大部分芯片可正常采购, 高端 FPGA 可能存在一定限制, 但目前无重大出货障碍。

三、在 H 客户测试流程中的定位与下游交付

测试环节覆盖:长川目前能满足 H 昇腾芯片的 FT(最终测试)环节, 以及普通 GPU 的测试; 但对昇腾下一代芯片的全面测试能力尚不确定。在 GPU 测试的 CP、FT、SLT(系统级测试)和 Burn-in(老化测试)四个步骤中, 9,016 型号仅用于 CP 和 FT 环节, SLT 和 Burn-in 不使用该型号。

下游交付去向:半导体测试设备的采购决策权在芯片设计原厂。H 采购的机台基本交付给测试厂芯云”(在杭州和诸暨设有工厂), 用于测试 GPU 以及 SoC 芯片(基站芯片、WiFi 等短距离通信芯片)。非 H 客户构成:主要包括盛合晶微、江苏新源等, 无锡伟测电子和渠梁等虽有接触但出货较少。

四、国产竞争格局与长川市场地位综合地位:长川与华峰之后是国内规模最大的两家企业。

长川综合实力和整体销售业绩在国内处于领先地位。竞争优势与劣势:长川产品线最全面, 覆盖分选机和测试机, 能满足大部分芯片测试需求。其他厂商(如华峰之后)产品线完整度较低, 但华峰之后在功率测试机这一细分领域表现突出, 出货量优于长川。营收与产品结构:2025 年测试机业务营收占比超 60%, 数字测试机是销售额和出货量的绝对主力。

其他产品线也有稳定出货(2021-2025 年 CIS 测试机累计出货约 300 台, LCD 约 100 台), 但占比相对较小。AI 测试机本质:A 测试机本质上是数字测试机的一种, 基于数字平台在板卡层面升级, 需配备更多数字板卡、电源板卡及 HXP-M32 等特定板卡。

五、海外拓展与生产运营情况海外拓展:长川有接触海外客户的计划,但当前战略重心集中于满足国内客户需求及确保新产品稳定量产。因技术距国际顶尖仍有差距,且大规模高质量生产体系复杂,公司在产品和生产体系完全成熟前对海外拓展持谨慎态度。生产模式:组装、测试和最终出货环节 100%由长川自主完成,不涉及委外加工。人才引进:长川会从爱德万等国际一线厂商引进核心研发人才,但规模极小(每年个位数),主要因为国际厂商在国内的核心研发岗位本就稀缺。